证券代码:002156 证券简称:通富微电 上市地点:深圳证券交易所

南通富士通微电子股份有限公司 重大资产购买报告书(草案)摘要

交易对方名称	交易对方通讯地址
Advanced Micro Devices, Inc.	One AMD Place, P.O. Box 3453, Sunnyvale, California 94088-3453

独立财务顾问 CMS 招商证券

二〇一六年三月

董事会声明

一、本公司董事会及全体董事保证本报告书内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料真实、完整。

三、本报告书所述事项并不代表中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。

四、本次交易完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;因本次交易引致的投资风险,由投资者自行负责;投资者在评价公司本次交易时,除本报告书及其摘要内容以及与本报告书同时披露的相关文件外,还应认真考虑本报告书披露的各项风险因素。

五、投资者若对本报告书存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

交易对方声明

本次重大资产购买的交易对方已出具承诺:

“作为本次交易的对方,Advanced Micro Devices, Inc.(“卖方”)承诺在合理要求的范围内,并受限于相关的保密承诺为重大资产重组提供在重大方面真实、准确和完整的以下信息的副本;

截至交割日向买方提供的每一目标公司的账簿和其他记录在各重要方面均为完整和准确的,反映实际正当交易,并在各重要方面根据良好商业惯例保存。”

本承诺函方承诺人的真实意思表示,对承诺人具有法律约束力,承诺人将自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督,积极采取合法措施履行本承诺,并依法承担相应责任。

释义

第一部分:常用词语		
通富微电、公司、本公司、上市公司、买方	指	南通富士通微电子股份有限公司
华达微电子	指	南通华达微电子集团有限公司
超威半导体、交易对方、AMD、卖方	指	Advanced Micro Devices, Inc.
AMD苏州	指	超威半导体技术(中国)有限公司
AMD槟城	指	Advanced Micro Devices Export SDN.BHD
标的公司、目标公司	指	AMD苏州和AMD槟城
标的资产	指	AMD苏州85%股权、AMD槟城85%股权
本次交易、本次重组、本次重大资产重组	指	通富微电现金收购AMD苏州85%股权、AMD槟城85%股权的行为
交易双方	指	通富微电与Advanced Micro Devices, Inc.
AMD中国	指	超威半导体(中国)有限公司
AMD马来西亚	指	Advanced Micro Devices SDN.BERHAD
富润达	指	南通富润达投资有限公司
通润达	指	南通通润达投资有限公司
矩天投资	指	矩天投资有限公司,英文名称Sky Giant Investment Limited
产业基金	指	国家集成电路产业投资基金股份有限公司
调整前交割价格、总体金额	指	根据《股权购买协议》,本次对标的资产的调整前交割价格为43,600本85%=37,060万美元
估值基准日	指	2015年9月30日
本报告书	指	《南通富士通微电子股份有限公司重大资产购买报告书(草案)摘要》
《股权购买协议》	指	南通富士通微电子股份有限公司与Advanced Micro Devices, Inc.签署的《股权购买协议》
交割日	指	《股权购买协议》中的交割先决条件已经全部满足或被受益方放弃之日后的第3个工作日
报告期	指	2013年、2014年及2015年9月30日
《共同投资协议》	指	《南通富士通微电子股份有限公司与国家集成电路产业投资基金股份有限公司之共同投资协议》
《售股权协议》	指	《南通富士通微电子股份有限公司国家集成电路产业投资基金股份有限公司之售股权协议》
《AMD苏州与AMD商英签署的《协议书》,该协议文本为《股权购买协议》的附件之一		
《马来西亚目标公司协议书》	指	AMD槟城与AMD商英签署的《协议书》,该协议文本为《股权购买协议》的附件之一
《中国目标公司制造服务协议》	指	AMD苏州与AMD商英签署的《制造服务协议》,该协议文本为《股权购买协议》的附件之一
《马来西亚目标公司制造服务协议》	指	AMD槟城与AMD商英签署的《制造服务协议》,该协议文本为《股权购买协议》的附件之一
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展与改革委员会
商务部	指	中华人民共和国商务部
招商证券	指	招商证券股份有限公司
致同会计师	指	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
第二部分:专业词语		
芯片	指	用半导体工艺在硅等材料上制造的集成电路
封装	指	将通过测试的晶圆加工得到独立芯片的过程,保护电路芯片免受周围环境的影响(包括物理(化学)影响),起着保护芯片、增强导热(散热)性能、实现电气和物理连接、功率分配、信号分配,以内通芯片内部与外部电路的作用
APU	指	加速处理器,系一系列由AMD公司推出,将中央处理器和独显核心集成在一个晶片上的芯片产品
CPU	指	中央处理器
SiP(SIP)	指	System in a Package的缩写,系统级封装
SOP	指	小尺寸封装
QFP	指	Quad Flat Package的缩写,四侧引脚扁平封装
TQFP	指	薄型封装方角扁平封装
MCM	指	多芯片组件封装技术
BGA	指	球栅阵列封装
PGA	指	插针网格阵列封装
LGA	指	栅格阵列封装
FC	指	Flip-Chip,倒装芯片,一种圆芯片封装技术
WLCSP	指	Wafer level Chip size package的缩写,晶圆级芯片尺寸封装
QFN	指	Quad Flat Non-leaded package的缩写,四侧无引脚扁平封装

** 本报告书中所列出的数据可能因四舍五入原因而与根据报告书中所列示的相关数据直接相加之和在尾数上有所不同。

第一节重大事项提示

本部分所述的词语或简称与本报告书“释义”中所定义的词语或简称具有相同的涵义。

一、本次交易方案主要内容

(一)本次交易方案概要

根据上市公司与AMD签订的《股权购买协议》,本次交易的标的为AMD位于中国的全资子公司AMD中国所持有AMD苏州85%股权,以及AMD位于马来西亚的全资子公司AMD马来西亚所持有的AMD槟城85%股权。

通富微电已就本次交易在境内分别于2015年10月10日和12月8日按照公司章程履行了全资子公司通润达和富润达,并通过该其持有的通润达100%股权和富润达100%股权,分别向AMD中国和AMD马来西亚增资,以向其提供本次交易所需的资金,并通过该其持有富润达50.52%和49.48%的股权,富润达与产业基金将分别持有富润达52.37%和47.63%的股权,通润达将作为收购AMD苏州股权的主体;同时,2015年11月17日通润达在香港投资的全资子公司新设投资将作为收购AMD槟城股权的主体。

(二)交易对方

上市公司本次重大资产重组的交易对方为超威半导体,其基本情况如下:

公司名称:ADVANCED MICRO DEVICES, INC.

公司类型:股份有限公司

成立日期:1969年5月1日

办公地址:One AMD Place, P.O. Box 3453, Sunnyvale, California 94088-3453

超威半导体是专门为计算机、通信和消费电子行业设计和制造各种创新的微处理器(CPU、GPU、APU、主板芯片组、电视卡芯片等)、闪存和低功率处理器解决方案的计算机领域的公司,是一家可以提供高性能CPU、高性能独立显卡GPU芯片、主板芯片组三大组件的半导体公司,超威半导体在世界各主要城市设有销售办事处,是一家真正意义上的跨国公司。

超威半导体于1972年9月1日在纽约证券交易所(NYSE)上市,交易代码为AMD,从2015年1月2日起,超威半导体股票从纽约证券交易所转至纳斯达克(NASDAQ),交易代码不变。

(三)标的投资者

本次交易的标的投资者为产业基金,其基本情况如下:

企业名称	国家集成电路产业投资基金股份有限公司
注册号	100000000045238
企业性质	股份有限公司(非上市)
成立日期	2014年9月26日
注册地址	北京市市辖区经济技术开发区景园北街2号52幢7层718室
法定代表人	王占甫
经营范围	股权投资、投资咨询;项目投资及资产管理;企业管理咨询
营业期限	自2014年9月26日至2024年9月25日

截至本报告书签署之日,产业基金与通富微电不存在任何关联关系。

(四)交易标的

本次交易标的为AMD苏州以及AMD槟城各85%股权,AMD苏州及AMD槟城的基本情况如下:

1.AMD苏州

名称	超威半导体技术(中国)有限公司
企业性质	有限责任公司(外国法人独资)
注册地址	苏州工业园区苏桐路88号
法定代表人	DEVINDER KUMAR
注册资本	13,338万美元
设立日期	2004年3月26日
统一社会信用代码	91320594759661883L
经营范围	特许经营项目:无 一般经营项目:生产集成电路和电子元件,销售本公司所生产的产品并提供有关的售后服务及相关服务,提供维修业务以及为相关产品提供技术服务;自有多余厂房出租。

2.AMD槟城

名称	ADVANCED MICRO DEVICES EXPORT SDN.BERHAD
注册地址	No. 368-3-1 & 2 Bellisa Row Jalan Burma Georgetown Pulau Pinang
注册号	40990-W
董事	Huang Peter, Devinder Kumar A/L Oom Parkash, Neoh Soon Ee
注册资本	1,570,000马来西亚林吉特
设立日期	1978年8月3日
主营业务	半导体集成电路的封装与测试

(五)实施主体

本次交易中用于收购AMD苏州85%股权的实施主体为通润达,用于收购AMD槟城85%股权的实施主体为通润达的全资子公司新天投资。

通润达的基本信息如下:

企业名称	南通通润达投资有限公司
统一社会信用代码	91320691MA1M9A603H
企业性质	有限责任公司(法人独资)
成立日期	2015年10月10日
注册地址	南通苏通科技产业园区江成路1088号内3号楼2778室
法定代表人	石磊
注册资本	3000万元
经营范围	股权投资、项目投资、项目及投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
营业期限	2015年10月10日至长期

新天投资的基本信息如下:

企业名称	新天投资有限公司
企业性质	有限责任公司
成立日期	2015年10月23日
注册地址	香港湾仔港湾道30号新鸿基中心1021室
股本	100万港元
经营范围	股权投资、项目投资、项目及投资管理

(六)交易价款及调价机制

1、交易价款及调价机制

本次交易的交割价款可拆分为:

总体金额=实际净负债(Actual Net Debt Amount)×85%+实际营运资金调整额(Actual Working Capital Adjustment Amount)×85%。

根据《股权购买协议》,本次交易的调整前交割价格为43,600×85%=37,060万美元,卖方须在交割日前至少5个工作日内,向买方提供按协议约定的方式计算的预计净债务、预计营运资金以及预计营运资金调整额,以及提供合理详细的支持性信息,并将于交割前尽快以书面方式告知通富微电对这些金额的任何最终变动。最终按照本次标的资产的交割日净债务、确定交割日标的资产购买价格。

交割完成后60日内,买方需向卖方提供截至交割日香港时间上午12:01分的标的公司的资产负债表,并计算实际净债务、实际营运资金以及实际营运资金调整额,交易双方据此调整交割日股权购买价格,并根据调整净额由买方或卖方进行差额支付。

对净债务调整额的调整方式为:

(1)如果实际净债务>期末债务-预计净债务,卖方需按照85%的比例向买方进行差额支付;

(2)如果实际净债务小于预计净债务,买方需按照85%的比例向卖方进行差额支付。

对营运资金调整额的调整方式为:

(1)如果实际营运资金调整额(Actual Working Capital Adjustment Amount)小于预估营运资金调整额(Estimated Working Capital Adjustment Amount),卖方需按照85%的比例向卖方进行差额支付;

(2)如果实际营运资金调整额大于预估营运资金调整额,公司需按照85%的比例向卖方对方进行差额支付。

实际债务净额=期末债务-期末现金

期末债务指截至交割日香港时间上午12:01,需在截至此时的目标公司的合并资产负债表中作为债务反映的、目标公司(作为一个整体)针对借款的所有债务,以及该等债务的应计未付利息;但是,期末债务应包括(a)未支取信用证及针对未支取信用证的偿付义务,及(b)与任何目标公司(作为一方)所欠的、以目标公司关联方(作为另一方)为受款人的与公司间债务相关的任何负债,减去与一家或多家目标公司关联方(包括受款方及其关联方)(作为一方)任何目标公司为受款人(作为另一方)的公司间债务相关的任何负债。

期末现金指截至交割日香港时间上午12:01,目标公司(作为一个整体)截至此时的所有合并现金及现金等价物,包括有价证券、任何现金抵押支持债券、许可或其他类似票据和任何存款(无论是否根据任何合同义务或其他规定以存款方式持有)。

实际运营资金金额指截至交割日标的公司的合并流动资产(不包括期末现金)-标的公司的合并流动负债(不包括期末债务)的差额。

实际营运资金调整额=实际营运资金金额-目标营运资金金额

关于交易双方根据调整净额,进行差额支付的假设测算如下:

交割日股权购买价格

项目	数额(百万美元)	备注
调整前交割价格	370.6	交易双方调整前交割价格初步确定为43,600万美元×85%
预计净债务	-10*	假设:预计净负债-1000万美元
预计营运资金调整额	-6*	
交割日股权购买价格	374	=370.6-(-10)×85%+(-6)×85%

交割完成后60日内,交易双方根据调整净额进行差额支付

项目	数额(百万美元)	备注
实际净债务	-6*	假设:实际净负债-600万美元
净债务调整额	-4	
实际营运资金调整额	-11*	
交割后调整总额	-7.65	正值表示买方向卖方进行差额支付;负值表示由卖方向买方进行差额支付; =(-4)×85%+(-11-(-6))×85%
实际股权购买价格	366.35	=374-7.65

注:上表中预计净债务-10百万美元,实际净债务-6百万美元,预计营运资金调整额6百万美元,实际营运资金调整额11百万美元为假设值,仅用于测算实际股权购买价格的调算过程。

2、交易价款调整的会计处理

股权交割日,交易双方根据交割日股权购买价格,确认合并成本。交割日后60日内,交易双方根据净债务、营运资金、营运资金调整额实际值与预计值之间的差异,对交割日所确定的股权初始投资成本进行调整。根据《上市公司执行企业会计准则案例解析》(证监会会计部),《企业会计准则讲解2010》、《企业会计准则第20号——企业合并》等相关规定,上市公司应做如下会计处理:

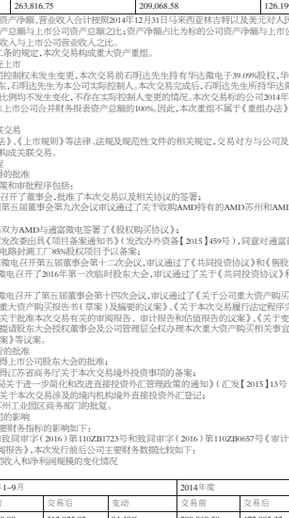
(1)股权交割日,交割日股权购买价格确认合并成本;

(2)交割日完成后60日内,根据上市公司对净债务、营运资金、营运资金调整额实际值与预计值之间差异所支付或收到的调整价款,作为公司在购买日后12个月内根据比现时购买日已存在的新的或者进一步证据而需要调整或有对价的情形进行处理,应视同在购买日发生,对合并成本进行追溯调整,相应调整商誉金额;

(3)上市公司在购买日后每一个资产负债表日,应需进行商誉减值测试,商誉一经减值,不得冲回。

(七)本次交易不会导致上市公司不具备股票上市条件

本次交易完成后,上市公司社会股东合计持有通润达不低于10%的股权,通润达拟通过其全资子公司新天投资将作为境外收购主体收购AMD苏州85%股权,矩天投资做为境外收购主体收购AMD槟城85%股权,收购完成后的股权架构如下:



3、对标的资产进行收购

通润达做为境内收购主体收购AMD苏州85%股权,矩天投资做为境外收购主体收购AMD槟城85%股权,收购完成后的股权架构如下:

三、本次交易符合《重组办法》第十一条对重大资产重组要求的情况

(一)符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定

本次重组符合国家相关产业政策,工业和信息化部发布的《集成电路行业“十二五”发展规划》中提出调整优化行业结构,着力发展芯片设计业,壮大芯片制造业,提升封装测试层次,增强关键设备、仪器、材料的自主开发和供给能力,按照“扶优、扶强、扶大”的原则,优化企业组织结构,推进企业兼并、重组,联合,本次重组的交易标的为AMD位于中国的全资子公司AMD苏州及AMD槟城各85%股权,AMD苏州为AMD槟城所有较强的封装与测试运营管理能力,收购后能为公司形成技术、产品、客户上的互补与协同,有利于公司的长远发展,同时,标的公司的生产经营符合本国及其所在国相关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定。

本次交易符合国家产业政策及有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定。

(二)本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件

本次重组拟采用收购AMD苏州及AMD槟城各85%股权,本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件。

(三)本次交易有助于提高上市公司资产的质量、改善公司财务状况和持续经营能力的情形

本次交易中,标的资产的调整前交割价格以招商证券估值基准日(2015年9月30日)的估值结论为参考,由交易双方协商确定。

本次交易所涉及的资产定价公允,不存在损害上市公司和股东合法权益的情形。本次交易按照相关法律法规的规定依法进行,由上市公司董事会提出方案,并聘请具有证券从业资格的中介机构依据有关规定出具审计、估值、法律等相关报告。

(四)本次交易向交易对方发行股份的情况

本次交易的标的公司为依照我国法律设立并有效存续的有限责任公司的股权,不存在出资不实或影响其合法存续的情形,交易对方承诺,交易对方所拥有的标的公司权属清晰、完整,不存在质押、权利担保或其它受限制的情形,能够按照交易约定进行过户,不存在重大法律障碍。

(五)本次交易有利于上市公司增强持续经营能力,不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形

本次交易前,上市公司的主营业务为通过子公司从事半导体企业提供IC的封装测试服务,主要封装产品包括SOP/SOT/TSSOP、QFP/LQFP、MCM(MCP)、QFN/PDFN、BGA、SiP、BUMP、WLCSP、Cu pillar、FC(Flip Chip)等系列产品,并提供微处理器、数字电路、模拟电路、数模混合电路、射频电路的PT测试及BPT预片测试服务,公司以封装测试业务为主,通过加大先进封装技术投入,通过引进先进的生产设备,不断提高产品的技术水平,开发新型产品,取得更高的利润率水平,获得优势地位。

标的公司掌握并应用PGA封装技术、BGA-stiffener封装技术、BGA-coreless封装技术以及LGA-coreless封装技术等世界主流先进封装技术,并具有国际先进的经营管理经验。本次交易完成后,上市公司将进一步巩固自身在国内行业领先的技术地位。

3、进一步提升上市公司的盈利能力

2015年1-9月,AMD苏州实现营业收入51,796.58万元,净利润4,207.55万元。2015年1-9月,AMD槟城实现营业收入92,463.91万元,净利润81,425.27万元。AMD苏州与AMD槟城营业收入合计144,260.49万元,净利润5,632.82万元。2015年1-9月,上市公司实现营业收入169,558.89万元,净利润12,169.94万元。本次交易完成后,将有利于上市公司提高盈利能力。

本次交易完成后,两家标的公司将成为上市公司的控股子公司,有利于公司纯粹开展各项业务及有效实施公司国际化发展战略,上市公司将在巩固核心业务的基础上,进一步开拓高端客户,在先进封装与测试领域的需求,在市场以及销售渠道的协同下,预计未来上市公司的盈利能力将进一步增强,符合全体股东的利益。

4、使公司跨身世界一流封测企业的行列

AMD苏州是世界一流封测企业的行列

AMD苏州是世界先进的微处理器封装测试企业,主要产品应用于电脑、服务器、高端游戏主机、云计算中心等高端领域,与通富微电目标发展的适用于通信及消费市场的倒装芯片封测技术形成互补,将显著提升公司倒装芯片封测技术,使公司在倒装芯片封测领域技术达到世界一流水平,提供封装品种最为完整的倒装芯片封测服务。这技术与公司已经在规模量产的Bumping(凸点制造)技术相配合,将显著提升公司在高端封测领域的服务能力和竞争力,也使公司能够更好的支持国产CPU、GPU、网关服务器、基站处理器、FPGA(现场可编程门阵列)等产品的研发和量产。

本次交易完成后,两家标的公司将作为AMD主要的封测供应商,继续为AMD提供高质量的先进封测服务,同时,将充分利用AMD先进的技术、稳定的品质、成熟的团队,充分利用这个成熟的、大规模量产的平台,为国内外有高端封测需求的客户提供规模化、个性化的先进封测服务,公司预计,未来先进封装测试的收入将占到公司收入的70%以上,在全行业中位于领先地位。本次交易能够显著提升公司的封测技术水平,进一步扩大公司的生产规模,提高公司的盈利能力,使公司跻身世界一流封测企业的行列。

二、本次交易的具体方案

(一)本次交易方案概要

根据上市公司与AMD签订的《股权购买协议》,本次交易的标的为AMD位于中国的全资子公司AMD中国所持有AMD苏州85%股权,以及AMD位于马来西亚的全资子公司AMD马来西亚所持有的AMD槟城85%股权。

通富微电已就本次交易在境内分别于2015年10月10日和12月8日按照公司章程履行了全资子公司通润达和富润达,并通过该其持有的通润达100%股权和富润达100%股权,分别向AMD中国和AMD马来西亚增资,以向其提供本次交易所需的资金,并通过该其持有富润达50.52%和49.48%的股权,富润达与产业基金将分别持有富润达52.37%和47.63%的股权,富润达与产业基金共同投资成立的全资子公司新天投资将作为收购AMD苏州股权的主体;同时,2015年11月17日通润达在香港投资的全资子公司矩天投资将作为收购AMD槟城股权的主体。

(二)交易对方

上市公司本次重大资产重组的交易对方为超威半导体,其基本情况如下:

公司名称:ADVANCED MICRO DEVICES, INC.

公司类型:股份有限公司

成立日期:1969年5月1日

办公地址:One AMD Place, P.O. Box 3453, Sunnyvale, California 94088-3453

超威半导体是专门为计算机、通信和消费电子行业设计和制造各种创新的微处理器(CPU、GPU、APU、主板芯片组、电视卡芯片等)、闪存和低功率处理器解决方案的计算机领域的公司,是一家可以提供高性能CPU、高性能独立显卡GPU芯片、主板芯片组三大组件的半导体公司,超威半导体在世界各主要城市设有销售办事处,是一家真正意义上的跨国公司。

超威半导体于1972年9月1日在纽约证券交易所(NYSE)上市,交易代码为AMD,从2015年1月2日起,超威半导体股票从纽约证券交易所转至纳斯达克(NASDAQ),交易代码不变。

(三)标的投资者

本次交易的标的投资者为产业基金,其基本情况如下:

企业名称	国家集成电路产业投资基金股份有限公司
注册号	100000000045238
企业性质	股份有限公司(非上市)
成立日期	2014年9月26日
注册地址	北京市市辖区经济技术开发区景园北街2号52幢7层718室
法定代表人	王占甫
经营范围	股权投资、投资咨询;项目投资及资产管理;企业管理咨询
营业期限	自2014年9月26日至2024年9月25日

截至本报告书签署之日,产业基金与通富微电不存在任何关联关系。

(四)交易标的

本次交易标的为AMD苏州以及AMD槟城各85%股权,AMD苏州及AMD槟城的基本情况如下:

1.AMD苏州

名称	超威半导体技术(中国)有限公司
企业性质	有限责任公司(外国法人独资)
注册地址	苏州工业园区苏桐路88号
法定代表人	DEVINDER KUMAR
注册资本	13,338万美元
设立日期	2004年3月26日
统一社会信用代码	91320594759661883L
经营范围	特许经营项目:无 一般经营项目:生产集成电路和电子元件,销售本公司所生产的产品并提供有关的售后服务及相关服务,提供维修业务以及为相关产品提供技术服务;自有多余厂房出租。

2.AMD槟城

名称	ADVANCED MICRO DEVICES EXPORT SDN.BERHAD
注册地址	No. 368-3-1 & 2 Bellisa Row Jalan Burma Georgetown Pulau Pinang
注册号	40990-W
董事	Huang Peter, Devinder Kumar A/L Oom Parkash, Neoh Soon Ee
注册资本	1,570,000马来西亚林吉特
设立日期	1978年8月3日
主营业务	半导体集成电路的封装与测试

(五)实施主体

本次交易中用于收购AMD苏州85%股权的实施主体为通润达,用于收购AMD槟城85%股权的实施主体为通润达的全资子公司新天投资。

通润达的基本信息如下:

企业名称	南通通润达投资有限公司
统一社会信用代码	91320691MA1M9A603H
企业性质	有限责任公司(法人独资)
成立日期	2015年10月10日
注册地址	南通苏通科技产业园区江成路1088号内3号楼2778室
法定代表人	石磊
注册资本	3000万元
经营范围	股权投资、项目投资、项目及投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
营业期限	2015年10月10日至长期

矩天投资的基本信息如下:

企业名称	矩天投资有限公司
企业性质	有限责任公司
成立日期	2015年10月23日
注册地址	香港湾仔港湾道30号新鸿基中心1021室
股本	100万港元
经营范围	股权投资、项目投资、项目及投资管理

(六)交易价款及调价机制

1、交易价款及调价机制

本次交易的交割日股权购买价格为:

总体金额=实际净负债(Actual Net Debt Amount)×85%+实际营运资金调整额(Actual Working Capital Adjustment Amount)×85%。

根据《股权购买协议》,本次交易的调整前交割价格为43,600×85%=37,060万美元,卖方须在交割日前至少5个工作日内,向买方提供按协议约定的方式计算的预计净债务、预计营运资金以及预计营运资金调整额,以及提供合理详细的支持性信息,并将于交割前尽快以书面方式告知通富微电对这些金额的任何最终变动,最终按照本次标的资产的交割日净债务、确定交割日标的资产购买价格。

交割完成后60日内,买方需向卖方提供截至交割日香港时间上午12:01分的标的公司的资产负债表,并计算实际净债务、实际营运资金以及实际营运资金调整额,交易双方据此调整交割日股权购买价格,并根据调整净额由买方或卖方进行差额支付。

对净债务调整额的调整方式为:

(1)如果实际净债务(Actual Net Debt Amount)大于预计净债务,卖方需按照85%的比例向买方进行差额支付;

(2)如果实际净债务小于预计净债务,买方需按照85%的比例向卖方进行差额支付。

对营运资金调整额的调整方式为:

(1)如果实际营运资金调整额(Actual Working Capital Adjustment Amount)小于预估营运资金调整额(Estimated Working Capital Adjustment Amount),卖方需按照85%的比例向卖方进行差额支付;

(2)如果实际营运资金调整额大于预估营运资金调整额,公司需按照85%的比例向卖方对方进行差额支付。

实际债务净额=期末债务-期末现金

期末债务指截至交割日香港时间上午12:01,需在截至此时的目标公司的合并资产负债表中作为债务反映的、目标公司(作为一个整体)针对借款的所有债务,以及该等债务的应计未付利息;但是,期末债务应包括(a)未支取信用证及针对未支取信用证的偿付义务,及(b)与任何目标公司(作为一方)所欠的、以目标公司关联方(作为另一方)为受款人的与公司间债务相关的任何负债,减去与一家或多家目标公司关联方(包括受款方及其关联方)(作为一方)任何目标公司为受款人(作为另一方)的公司间债务相关的任何负债。

期末现金指截至交割日香港时间上午12:01,目标公司(作为一个整体)截至此时的所有合并现金及现金等价物,包括有价证券、任何现金抵押支持债券、许可或其他类似票据和任何存款(无论是否根据任何合同义务或其他规定以存款方式持有)。

实际运营资金金额指截至交割日标的公司的合并流动资产(不包括期末现金)-标的公司的合并流动负债(不包括期末债务)的差额。

实际营运资金调整额=实际营运资金金额-目标营运资金金额

关于交易双方根据调整净额,进行差额支付的假设测算如下:

交割日股权购买价格

项目	数额(百万美元)	备注
调整前交割价格	370.6	交易双方调整前交割价格初步确定为43,600万美元×85%
预计净债务	-10*	假设:预计净负债-1000万美元
预计营运资金调整额	-6*	
交割日股权购买价格	374	=370.6-(-10)×85%+(-6)×85%

交割完成后60日内,交易双方根据调整净额进行差额支付

项目	数额(百万美元)	备注
实际净债务	-6*	假设:实际净负债-600万美元
净债务调整额	-4	
实际营运资金调整额	-11*	
交割后调整总额	-7.65	正值表示买方向卖方进行差额支付;负值表示由卖方向买方进行差额支付; =(-4)×85%+(-11-(-6))×85%
实际股权购买价格	366.35	=374-7.65

注:上表中预计净债务-10百万美元,实际净债务-6百万美元,预计营运资金调整额6百万美元,实际营运资金调整额11百万美元为假设值,仅用于测算实际股权购买价格的调算过程。

2、交易价款调整的会计处理

股权交割日,交易双方根据交割日股权购买价格,确认合并成本。交割日后60日内,交易双方根据净债务、营运资金、营运资金调整额实际值与预计值之间的差异,对交割日所确定的股权初始投资成本进行调整。根据《上市公司执行企业会计准则案例解析》(证监会会计部),《企业会计准则讲解2010》、《企业会计准则第20号——企业合并》等相关规定,上市公司应做如下会计处理:

(1)股权交割日,以交割日股权购买价格确认合并成本;

(2)交割日完成后60日内,根据上市公司对净债务、营运资金、营运资金调整额实际值与预计值之间差异所支付或收到的调整价款,作为公司在购买日后12个月内根据比现时购买日已存在的新的或者进一步证据而需要调整或有对价的情形进行处理,应视同在购买日发生,对合并成本进行追溯调整,相应调整商誉金额;

(3)上市公司在购买日后每一个资产负债表日,应需进行商誉减值测试,商誉一经减值,不得冲回。

(七)本次交易的主要步骤

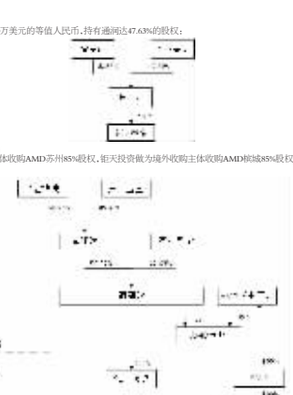
1、与战略投资者共同设立第一层持股公司

通富微电已就本次交易在境内分别于2015年10月10日、11月17日和12月8日设立(或投资)了通润达、矩天投资和富润达,并通过将持有的通润达100%或权转让给富润达的方式间接持有通润达和矩天投资各100%的股权。

产业基金拟根据通富微电与产业基金签署的《共同投资协议》的约定向通润达和富润达增资,增资完成后,通富微电和产业基金将分别持有富润达50.52%和49.48%的股权。

2、第一层持股公司与战略投资者共同持有第二层持股公司

富润达与产业基金将合计持有通润达100%股权,其中富润达认缴出资19,795万美元的等值人民币,持有通润达52.37%的股权,产业基金认缴出资18,000万美元的等值人民币,持有通润达47.63%的股权;



3、对标的资产进行收购

通润达做为境内收购主体收购AMD苏州85%股权,矩天投资做为境外收购主体收购AMD槟城85%股权,收购完成后的股权架构如下:

三、本次交易符合《重组办法》第十一条对重大资产重组要求的情况

(一)符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定

本次重组符合国家相关产业政策,工业和信息化部发布的《集成电路行业“十二五”发展规划》中提出调整优化行业结构,着力发展芯片设计业,壮大芯片制造业,提升封装测试层次,增强关键设备、仪器、材料的自主开发和供给能力,按照“扶优、扶强、扶大”的原则,优化企业组织结构,推进企业兼并、重组,联合,本次重组的交易标的为AMD位于中国的全资子公司AMD苏州及AMD槟城各85%股权,AMD苏州为AMD槟城所有较强的封装与测试运营管理能力,收购后能为公司形成技术、产品、客户上的互补与协同,有利于公司的长远发展,同时,标的公司的生产经营符合本国及其所在国相关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定。

本次交易符合国家产业政策及有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定。

(二)本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件

本次重组拟采用收购AMD苏州及AMD槟城各85%股权,本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件。

(三)本次交易有助于提高上市公司资产的质量、改善公司财务状况和持续经营能力的情形

本次交易中,标的资产的调整前交割价格以招商证券估值基准日(2015年9月30日)的估值结论为参考,由交易双方协商确定。

本次交易所涉及的资产定价公允,不存在损害上市公司和股东合法权益的情形。本次交易按照相关法律法规的规定依法进行,由上市公司董事会提出方案,并聘请具有证券从业资格的中介机构依据有关规定出具审计、估值、法律等相关报告。

(四)本次交易向交易对方发行股份的情况

本次交易的标的公司为依照我国法律设立并有效存续的有限责任公司的股权,不存在出资不实或影响其合法存续的情形,交易对方承诺,交易对方所拥有的标的公司权属清晰、完整,不存在质押、权利担保或其它受限制的情形,能够按照交易约定进行过户,不存在重大法律障碍。

(五)本次交易有利于上市公司增强持续经营能力,不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形

本次交易前,上市公司的主营业务为通过子公司从事半导体企业提供IC的封装测试服务,主要封装产品包括SOP/SOT/TSSOP、QFP/LQFP、MCM(MCP)、QFN/PDFN、BGA、SiP、BUMP、WLCSP、Cu pillar、FC(Flip Chip)等系列产品,并提供微处理器、数字电路、模拟电路、数模混合电路、射频电路的PT测试及BPT预片测试服务,公司以封装测试业务为主,通过加大先进封装技术投入,通过引进先进的生产设备,不断提高产品的技术水平,开发新型产品,取得更高的利润率水平,获得优势地位。

标的公司掌握并应用PGA封装技术、BGA-stiffener封装技术、BGA-coreless封装技术以及LGA-coreless封装技术等世界主流先进封装技术,并具有国际先进的经营管理经验。本次交易完成后,上市公司将进一步巩固自身在国内行业领先的技术地位。

3、进一步提升上市公司的盈利能力

2015年1-9月,AMD苏州实现营业收入51,796.58万元,净利润4,207.55万元。2015年1-9月,AMD槟城实现营业收入92,463.91万元,净利润81,425.27万元。AMD苏州与AMD槟城营业收入合计144,260.49万元,净利润5,632.82万元。2015年1-9月,上市公司实现营业收入169,558.89万元,净利润12,169.94万元。本次交易完成后,将有利于上市公司提高盈利能力。

本次交易完成后,两家标的公司将成为上市公司的控股子公司,有利于公司纯粹开展各项业务及有效实施公司国际化发展战略,上市公司将在